

(54) CHARACTERISTIC MEASUREMENT OF SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 58-169068 (A) (43) 5.10.1983 (19) JP

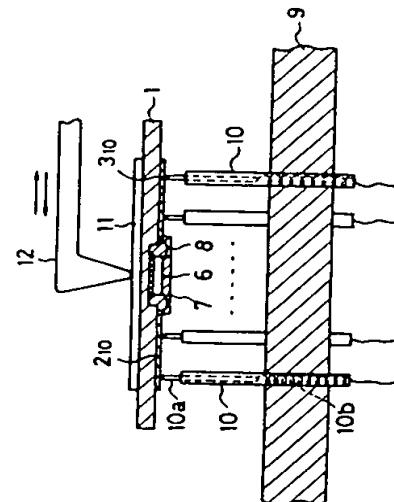
(21) Appl. No. 57-53454 (22) 31.3.1982

(71) TOKYO SHIBAURA DENKI K.K. (72) KUNIO TODA

(51) Int. Cl. G01R31/26//H01L21/66

PURPOSE: To improve the accuracy of a measuring test with a contacting property of measuring terminal by removing an oxide film with a friction caused between a contact pad and measuring terminal with an ultrasonic vibration.

CONSTITUTION: Prior to the start of a measuring test, a lateral vibration is applied on a glass epoxy substrate 1 through a protection plate 11 with an ultrasonic vibrator 12 to cause a friction between the tip of a measuring terminal 10 with a spring and contact pads 2₁₀ and 3₁₀. As the measuring terminal 10 is kept contact with the contact pads by an elastic force of the spring 10b, a thin oxide film formed on the surface of the contact pads is removed by a friction force. Upon the removal of the oxide film, the ultrasonic vibrator 12 is halted and then, a main measuring test is conducted. Thus, the accuracy of the measuring test can be improved with a higher contacting property.



(54) TESTER FOR HYSTERESIS INPUT CIRCUIT

(11) 58-169069 (A) (43) 5.10.1983 (19) JP

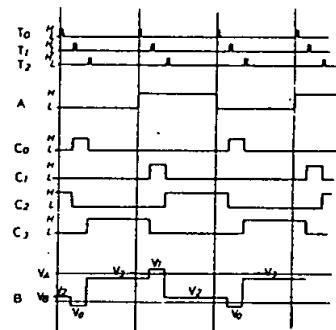
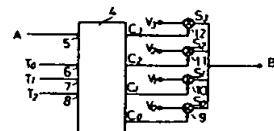
(21) Appl. No. 57-53080 (22) 31.3.1982

(71) FUJITSU K.K. (72) SABUROU TOKUYAMA

(51) Int. Cl. G01R31/28

PURPOSE: To reduce the testing time by checking a hysteresis input circuit for hysteresis characteristic simultaneously with a function test of an integrated circuit each time level "L" and "H" signals are repeated.

CONSTITUTION: An input data is inputted into a logic input terminal 5 of a control circuit 4 while timing signals T₀~T₂ are inputted respectively into timing input terminals 6~8. It is that input data A changes from "L" to "H" and "L" in the level at the timing T₀. The control circuit 4 turns ON an electronic switch S₀ at the timing T₁ to shift the output data B of an output terminal 13 to a voltage V₀ and then, turns ON a switch S₃ at the timing T₂ to shift the data B to V₃. Thereafter, the data B shifts to V₁, V₂, V₀ and V₃ at the timings as illustrated. Under this condition, the output data B designates the input of a Schmitt trigger circuit to "L" and "H" at the timing T₁. If the hysteresis characteristic of the Schmitt trigger circuit, an error occurs in the judgement thereby enabling the inspection of hysteresis characteristics.



(54) SQUID FLUXMETER

(11) 58-169070 (A) (43) 5.10.1983 (19) JP

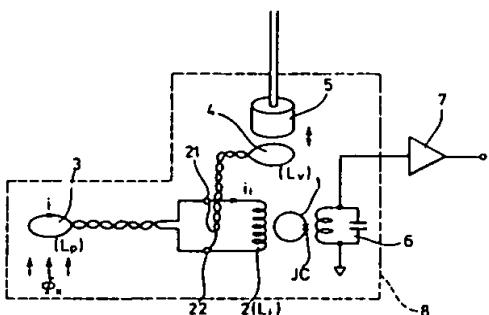
(21) Appl. No. 57-52931 (22) 31.3.1982

(71) YOKOGAWA DENKI SEISAKUSHO K.K. (72) SEIICHI NAITOU(1)

(51) Int. Cl. G01R33/035

PURPOSE: To achieve a handy measurement of an absolute value of a DC magnetic flux by varying inductance of a detection coil or inductance of a coil connected in parallel with to an input coil.

CONSTITUTION: A superconductive ring 1, an input coil 2, terminals 21 and 22, a pickup coil 3, a coil 4, a superconductive member 5 and an LC resonance circuit 6 are all housed in a cryostat 8, for example, and maintained at the helium temperature. As soon as a magnetic flux ϕ_s enters a pickup coil 3 from outside, a shield current (i) flows therethrough 3 to maintain the magnetic flux within a superconductive closed loop at a constant level, allowing a current i₁ to flow through the input coil 2. The current i₁ changes in proportion to the value ϕ_s , with a continuous variation in the inductance L_v of the coil 4 and the inductance L_p of the pickup coil 3, thereby enabling the measurement the magnetic flux ϕ_s from outside even when it is a DC magnetic field.



09 日本国特許庁 (JP)

IP 特許出願公開

12 公開特許公報 (A)

昭58-169068

Int. Cl.³
G 01 R 31/26
H 01 L 21/66

識別記号

庁内整理番号
7359--2G
6851--5F

43公開 昭和58年(1983)10月5日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 3 頁)

50半導体装置の特性測定方法

21特 願 昭57-53454
22出 願 昭57(1982)3月31日
22發明者 戸田邦男
川崎市幸区小向東芝町1番地東京芝浦電気株式会社トランジス
タ工場内出願人 東京芝浦電気株式会社
川崎市幸区堀川町72番地

代理人 弁理士 鈴江武彦 外2名

明細書

1. 発明の名称

半導体装置の特性測定方法

2.特許請求の範囲

半導体素子から複数の接触用パッドが取り出された半導体装置の当該接触用パッドのそれぞれに、支持体上に植立されたスプリング付測定用端子を接触させて特性を測定する半導体装置の特性測定方法において、前記半導体装置の接触用パッドを前記スプリング付測定用端子に接触させて、前記半導体装置若しくは前記支持体に振動を与えて測定を行うことを特徴とする半導体装置の特性測定方法。

3. 発明の詳細な説明

〔発明の技術分野〕

この発明は半導体装置の特性測定方法に係り、特に液晶表示の時計の表示を基板に組込んだ後のその特性を測定する方法に関する。

〔発明の技術的背景〕

液晶表示の時計用LSI(大規模集積回路)

チップは、通常両面に、液晶と接触をとるためのLCD (Liquid Crystal Display) パッド等の接触パッドがバターニングされた例えばガラスエポキシ基板の所定位臍に組込まれるようになつていて。

ところで、この基板に組込まれたLSIチップはその後特性が良好か否かを判断し選別する必要がある。この測定は、上記接触用パッドにそれぞれ測定用端子の先端を接触させて行うものであるが、接触用パッドの数が極めて多いため、従来、これら接触用パッドに対応して設けられた複数の測定用端子に全ての接触用パッドを同時に接触させてその測定を行つてはいる。測定用端子としては、例えば内部にスプリングを有し、このスプリングの弾性力によつて接触用パッドとの接触を保つスプリング付測定用端子が用いられている。

〔背景技術の問題点〕

しかしながら、上記のようなガラスエポキシ基板の接触用パッドでは、取扱い中にその表面

に薄い酸化膜が形成されてしまう。このような酸化膜が存在すると、測定用端子のスプリングの弾性力のみでは、接触用パッドと測定用端子との良好な接触を保つことができない。例えば、測定用端子の先端が平面である場合には接触面積は大きくなるが、単位面積当たりの圧力が低下し、酸化膜を突き破ることができず、接触不良となる。逆に、測定用端子の先端が锐利になると、圧力が上がり酸化膜を突き破ることができると本質的に点接触になるため接触抵抗の増大を招くことになる。従つて、いずれにしてもスプリング付測定用端子のみでは接触用パッドとの良好な接触は認めなかつた。

(発明の目的)

この発明は上記実情に鑑みてなされたもので、その目的は、接触用パッドと測定用端子との接触を良好に保ち、信頼性の向上した測定が可能な半導体装置の特性測定方法を提供することにある。

ボンディングワイヤ⑧により接続されている。なお、ガラスエポキシ基板①の裏面にも各種パッドがバターニングされている。

第2図はこのLSIチップ⑥が組込まれたガラスエポキシ基板①の特性を測定する方法を示すものである。同図において、⑨は例えばアクリル樹脂製のソケットであり、このソケット⑨には上記ガラスエポキシ基板①の接触用パッドに対応して複数の貫通孔が形成されており、これら貫通孔にそれぞれスプリング付測定用端子⑩が植立して固定されている。このスプリング付測定用端子⑩は前述のように内部にスプリング⑪が設けられており、このスプリングの弾性力によって内部端子⑩を上に押上げるようになつてある。しかして、これら測定用端子⑩の先端部は同一高さに設定され、これら先端部上にはガラスエポキシ基板(第2図においては第1図のX-X'線に沿つた断面図で示されている。)①がLSIチップ⑥を下にして所定の位置に設置されており、これによ

(発明の概要)

この発明は、接触用パッドの表面にスプリング付測定用端子の先端を接触させて、測定試験を行う前に、例えばガラスエポキシ基板を超音波振動子により振動させ、これによつて生ずる接触用パッドと測定用端子との間の摩擦により接触用パッド表面の酸化膜を除去するものである。

(発明の実施例)

以下、図面を参照してこの発明の一実施例を説明する。第1図において、①は液晶表示の時計用LSIのガラスエポキシ基板であり、この基板①の表面には複数の接触用のLCDパッド②、③及びその他の接触用パッド④、⑤、⑥がバターニングされると共にその中央の開口部には第2図に示すようにLSIチップ⑥が固定され、さらにこのLSIチップ⑥が例えばエポキシ樹脂⑦により樹脂封止されている。LSIチップ⑥の各電極と各LCDパッド②、③、④、⑤とはそれぞれ

リスプリング付測定用端子⑩と接触用パッドとの接触が保たれている。さらに、ガラスエポキシ基板①の裏面上には例えばエポキシ樹脂製の保護板⑪が設置されており、この保護板⑪の上面に超音波振動子⑫の先端部が当接している。この超音波振動子⑫は図に矢印で示すように左右に振動するもので、これによりガラスエポキシ基板①に振動を与えるようになつてある。

すなわち、この方法においては、測定試験を開始する前に、超音波振動子⑫により保護板⑪を介してガラスエポキシ基板①に左右の振動を与え、スプリング付測定用端子⑩の先端部と接触用パッド(第2図ではLCDパッド②、③、④)との間に摩擦を起させるものである。ここで、測定用端子⑩と接触用パッドとの間はスプリング⑪の弾性力により接触状態を保つてゐるため、接触用パッドの表面にできた薄い酸化膜が摩擦力により除去される。酸化膜が除去されると、超音波振動子⑫を停止

させ、本来の測定試験を行う。

このように酸化膜が除去された接触用パッドでは、測定用端子10の接触性が向上し、測定試験の精度が向上する。

尚、上記実施例においては、超音波振動子12をガラスエポキシ基板1側に当接させ接触用パッドを振動させるようにしたが、これに限るものではなく、ソケット2側に超音波振動子12を当接させスプリング付測定用端子10を振動させるようにしても良いことは勿論である。

(発明の効果)

以上のようにこの発明によれば、接触用パッドと測定用端子との接触を良好に保つことができる、測定精度が著しく向上する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は時計用LSIチップが組込まれたガラスエポキシ基板の平面図、第2図はこの発明の一実施例を示す断面図である。

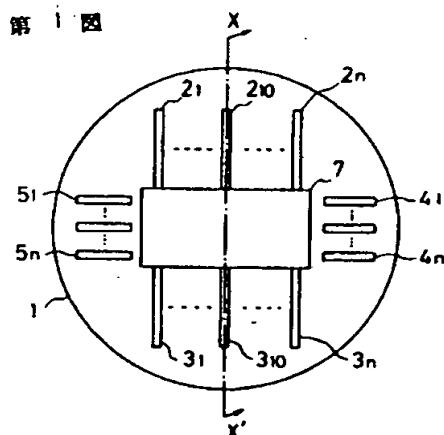
1…ガラスエポキシ基板

2₁～2_n、3₁～3_n…LCDパッド(接触用パッド)

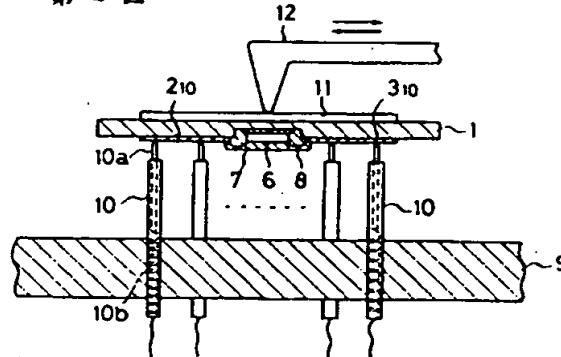
9…ソケット、10…スプリング付測定用端子
11…保護板、12…超音波振動子

出願人代理人 井理士 鈴 江 武 彦

第1図



第2図



BEST AVAILABLE COPY